

Materialien für die Elektronikfertigung ? Bleifreie, no-clean und halogenfreie Lotpasten für alle Anwendungsbereiche bis Ultra-Fine-Pitch

Materialien für die Elektronikfertigung - Bleifreie, no-clean und halogenfreie Lotpasten für alle Anwendungsbereiche bis Ultra-Fine-Pitch

John-338 Familie anbieten. Generell geht es bei halogenfreien Lotpasten um einen aktiven Umweltschutz, da die Elemente Fluor, Brom, Iod und Chlor nicht enthalten sein dürfen. Die Lotpasten der Familie OM-338 erfüllen diese Standards ohne dabei auf die geforderten guten Benetzungs- und Aufschmelzeigenschaften verzichten zu müssen.

John-338 erfüllen diese Standards ohne dabei auf die geforderten guten Benetzungs- und Aufschmelzeigenschaften verzichten zu müssen.

John-338 erfüllen diese Standards ohne dabei auf die geforderten guten Benetzungs- und Aufschmelzeigenschaften verzichten zu müssen.

John-338 erfüllen diese Standards ohne dabei auf die geforderten guten Benetzungs- und Aufschmelzeigenschaften verzichten zu müssen.

John-338 erfüllen diese Standards ohne dabei auf die geforderten guten Benetzungs- und Aufschmelzeigenschaften verzichten. Die zu 200 mm/Sek. möglich. Weitere Vorteile sind das große Zeitfenster für Reflow-Prozesse und die hervorragende Beständigkeit gegenüber Lunkerbildung. Basierend auf der OM338-T gibt es auch eine nadeltestbare Version: Die ALPHA OM-338PT. Dieser robuste Lotpastentyp überzeugt durch gutes Schablonentrennverhalten und ermöglicht eine hervorragende Nadelprüfbarkeit nach dem Löten. Die OM-338PT hat eine höhere Viskosität für optimale Klebrigkeit bei der Bestückung. Sie überzeugt durch ausgezeichnete Druckeigenschaften mit diversen geschlossenen Druckkopfsystemen und bietet ein großes Prozessfenster bei Druckgeschwindigkeiten von bis zum 150 mm/Sek.

John-Sek. br. /- Bestens geeignet für ultrafeine Strukturen, <0,4 mm Pitch, ist die ALPHA OM-338CSP. Durch das hierbei eingesetzte spezielle Pulver, wurden die Druckeigenschaften der Lotpaste gegenüber eines herkömmlichen Pulvers des Typs 3 oder 4 entscheidend verbessert. Die OM338CSP verfügt über eine ausgezeichnete Klebrigkeit.

John-Sek. br. /- Setten bei ve

gegenüber eines herkömmlichen Pulvers des Typs 3 oder 4 entscheidend verbessert. Die OM338CSP verfügt über eine ausgezeichnete Klebrigkeit />Weitere Informationen erhalten Sie bei: br />Blume Elektronik Distribution GmbH br />TecCenter 1 br />31162 Bad Salzdetfurth br />Telefon: (0 2712-0 br />Fax: (05063) 2712-12 br />E-Mail: info@blume-elektronik.de lume-elektronik.de br />Internet: www.blume-elektronik.de www.blume-elektronik.de	
Pressekontakt	
Blume Elektronik	
31162 Bad Salzdetfurth	
If@mediaberatung.de	
Firmenkontakt	
Blume Elektronik	
31162 Bad Salzdetfurth	
If@mediaberatung.de	
Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage	